

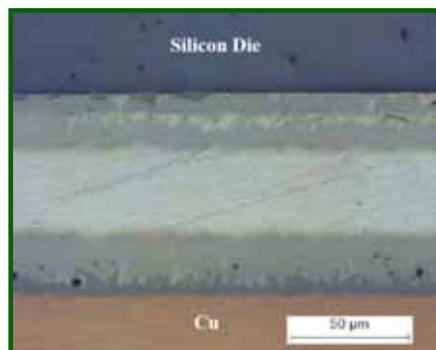


Special Laminate Composite Preform

米Indium Corporationの
新技術による
3層構造のプリフォーム半田

Pb系/Au系プリフォーム半田の代替に！

SnAg/Ag/SnAgの3層構造
優れた延性/引張強度による信頼性
リメルト温度は450 以上
AuSn、AuGeに対する価格優位性

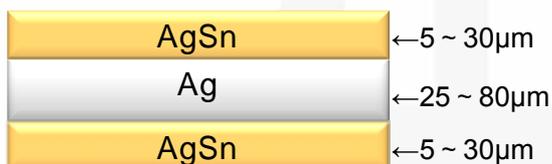


【使用時の特徴】

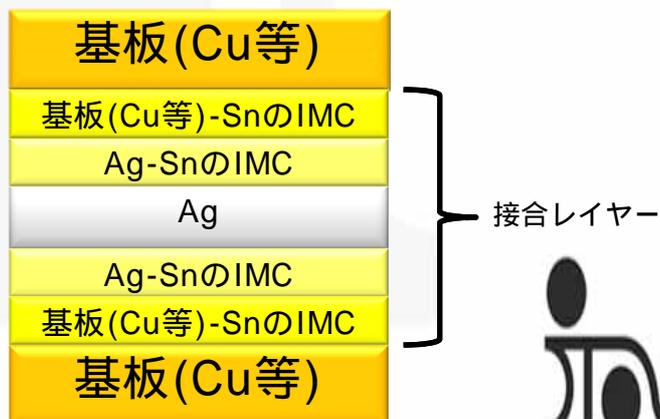
- ・ オープンで380 -9分加熱すれば液相拡散接合が終了
(保持時間、本製品の厚み次第で最低280 での接合も可能)
- ・ コーティング層(SnAg)がIMCを形成
- ・ ボイド除去のため0.3MPa程度の圧力が必要

使用前後イメージ

接合前



接合後



巴工業株式会社

